

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成23年2月24日(2011.2.24)

【公表番号】特表2010-518603(P2010-518603A)

【公表日】平成22年5月27日(2010.5.27)

【年通号数】公開・登録公報2010-021

【出願番号】特願2009-548351(P2009-548351)

【国際特許分類】

H 01 L 31/04 (2006.01)

G 02 B 3/00 (2006.01)

【F I】

H 01 L 31/04 Z

G 02 B 3/00 Z

【手続補正書】

【提出日】平成23年1月4日(2011.1.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

凹部を画定する表面を含んでいる光学素子を生成するステップと、  
前記表面上に導電材料を堆積して、前記堆積された導電材料の一部が前記凹部内に配置  
されるようにするステップと、  
前記表面をほぼ平坦化させて、前記凹部内に配置された導電材料の一部を露出させるス  
テップとを含む方法。

【請求項2】

前記表面をほぼ平坦化するステップが、前記導電材料および表面を化学機械的に研磨す  
るステップを含んでいる、請求項1に記載の方法。  
【請求項3】

前記導電材料を堆積させるステップが、前記光学素子の上に溶融導電材料を溶射するス  
テップを含んでいる、請求項1に記載の方法。

【請求項4】

前記導電材料を堆積させるステップが、前記光学素子の上に溶融導電材料を溶射する前  
に、前記光学素子の上にステンシルを配置するステップを更に含んでいる、請求項3に記  
載の方法。

【請求項5】

前記光学素子の上に反射材料を堆積させ、且つ前記表面に前記反射材料が付着しないよ  
うにするステップと、

前記反射材料の上に電気絶縁体を堆積させ、前記表面に前記電気絶縁体が付着しないよ  
うにするステップと、

前記導電材料を前記電気絶縁体の上に堆積させるステップとを更に含んでいる、請求項  
1に記載の方法。

【請求項6】

凹部を画定する表面を含む光学素子と、

前記凹部内に配置された導電材料と、

前記導電材料の一部に被せて配置された半田マスクとを含んでいて、

前記半田マスクが、前記光学素子からの光が透過可能な開口部を画定する装置。

**【請求項 7】**

凹部を画定する表面を含む光学素子を生成するステップと、

前記凹部以外の表面の領域の上に材料を堆積させるステップと、

前記材料の上、且つ前記凹部内に導電材料を堆積させるステップと、

その上に堆積された材料および任意の導電材料を除去するステップとを含む方法。

**【請求項 8】**

光学素子の上に導電材料を堆積させるステップと、

前記導電材料の上にフォトレジストを堆積させるステップと、

前記フォトレジストの一部を除去して前記導電材料の一部を露出させるステップと、

第2の導電材料により前記導電材料の露出部分にメッキを施すステップと、

前記フォトレジストの残りの部分を除去するステップと、

前記導電材料の非メッキ部分を除去するステップとを含む方法。